

Bienvenido a O-Leading

Somos fabricantes profesionales de PCB con más de diez años de experiencia. Productos de gama única, doble cara, PCB multicapa, PCB flexible y MCPCB. Podemos proporcionar un servicio rápido de prototipos: S / S en 24 horas, 4-8 capas en 48-96 horas de tiempo de producción.

PLACA DE COBRE AGUJEROS MÍNIMO .025 AVG, .020 MIN. LOS AGUJEROS NO SE PUEDEN CONECTAR

Paquete con película de burbuja transparente incolora, 25 PCS / bolsa, coloque el desecante en el flanco, coloque la tarjeta indicadora de humedad en la parte superior

Descripción del producto

Descripción del producto:

Detalles Rápidos

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-Leading
Material de base	FR-4, Aluminio	Espesor de cobre	0.5 oz-5 oz
Min. Tamaño del agujero	0.2mm	Min. Grosor de línea	0.2mm
Acabado de superficies aplicable a	inmersión en oro, OSP, HASL sin plomo.	precio	\$ 0.1- \$ 10
certificados	Led, teléfono móvil, aires acondicionados, lavadoras.	personaje	Pcb de control industrial
peso	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
color	0.01kg -5kg	MOQ	10 unids
Número de modelo	azul, rojo, verde, negro.yellow	Espesor del tablero	0.1-5mm
tipo desigh	fabricante de pcha de montaje de pcb de banco de potencia	tamaño	0.01m3-10m3
	requisito del cliente	Min. Espaciado entre líneas	0.2mm

Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque:	16 años de fabricante profesional del tablero del PWB del OEM
Detalle de la entrega:	7-12days

Descripción del producto

16 años de fabricación profesional del tablero del PWB del OEM

Ítem	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48
Línea mínima / espacio (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de perforación min diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Relleno de placa via	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Min. grosor del núcleo (excluir cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro del taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40
Via enterrada agujero / apilado a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					
Condensador integrado PCB	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Proceso de superficie	HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata de inmersión, lata de inmersión, Destello dorado, chapado en oro, chapado en oro duro selectivo, Máscara de soldadura pelable, tinta al carbono					



www.o-leading.com

Fabricación de pcb de alta calidad

Nuestro equipo





Certificaciones



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [online family of databases](#).
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED

E490354

Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

	Cond Width			SS/ DS/	Area Diam	Solder		Temp		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Class	DSR				
Typ	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	
Multi-layer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.25	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.03)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	
O-LEADING-205												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

http://www.ul.com/onlinecertifications/UL60718RMS/ewg/zpmv2.e490354/Wiring,Printed-Component/10



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online certification platform, which provides a secure and efficient way to manage your certification needs. The platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, allowing you to view your certification status, download certificates, and manage your account information. For more information, please visit [www.sgscertification.com](#).

Member of the SGS Group (SGLS)

Embalaje y & Entrega

detalles del empaque	16 años de fabricante profesional del tablero del PWB del OEM
Detalle de la entrega	7-12days



Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo garantiza O-Leading la calidad?

Nuestro alto estándar de calidad se logra con lo siguiente.

1. El proceso está estrictamente controlado según las normas ISO 9001: 2008.
2. Amplio uso del software en la gestión del proceso de producción.
3. Equipos y herramientas de prueba de estado de arte. P.ej. Sonda de vuelo, inspección de rayos X, AOI (Inspector óptico automatizado) y ICT (pruebas en circuito).
4. Equipo de control de calidad dedicado con un proceso de análisis de caso de falla.
5. Capacitación y educación continua del personal.

2. ¿Cómo O-Leading mantiene su precio competitivo?

Durante la última década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos químicos) se duplicaron, triplicaron o cuadruplicaron; La moneda china RMB había apreciado un 31% sobre el dólar estadounidense; Y nuestro coste laboral también aumentó significativamente. Sin embargo, O-Leading ha mantenido nuestros precios estables. Esto es totalmente propio de nuestras innovaciones en la reducción de costos, evitando desperdicios y mejorando la eficiencia. Nuestros precios son muy competitivos en la industria al mismo nivel de calidad.

Creemos en una asociación de ganar-ganar con nuestros clientes. Nuestra asociación será mutuamente beneficiosa si podemos proporcionarle una ventaja en el costo y la calidad.

3. ¿Qué tipo de tableros puede el proceso O-Leading?

Tableros FR4 comunes, de alto TG y libres de halógenos, Rogers, Arlon, Telfon, tableros de aluminio / cobre, PI, etc.

4. ¿Qué datos se necesitan para la producción de PCB?

Es mejor proporcionar datos en formato Gerber 274-X. Además, también se pueden procesar Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP y Eagle.

5. ¿Cuál es el flujo de proceso típico para PCB multicapa?

Corte de material → Película seca interna → grabado interno → AOI interior → Multi-bond → Apilado de capas Presionando → Perforación → PTH → Revestimiento del panel → Película seca exterior → Revestimiento de patrones → Grabado exterior → AOI exterior → Máscara de soldadura → Marca de componente → Acabado de superficie → Encaminamiento → E / T → Inspección visual.